

# 2017-2022年中国LED封装市场全景调查与市场供需预测报告

## 报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

[www.abaogao.com](http://www.abaogao.com)

## 一、报告报价

《2017-2022年中国LED封装市场全景调查与市场供需预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/xiaojiadian/E17161YAWS.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

2015年开始，我国LED封装器件价格下滑力度极大，超过50%。行业多年混战的氛围亟待解决，正式进入竞争淘汰期。价格的持续下滑带来的渗透率上移、新兴市场的推动、芯片端涨价、下游需求增加等因素使得2016年LED封装行业缓慢回暖，需求量呈上升态势。

### LED封装产值走势

智研数据研究中心发布的《2017-2022年中国LED封装市场全景调查与市场供需预测报告》共八章。首先介绍了LED封装产业相关概念及发展环境，接着分析了中国LED封装行业规模及消费需求，然后对中国LED封装行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国LED封装行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国LED封装行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

### 第一章 LED封装相关概述

#### 1.1 LED封装简介

##### 1.1.1 LED封装的概念

##### 1.1.2 LED封装的形式

##### 1.1.3 LED封装的结构类型

##### 1.1.4 LED封装的工艺流程

#### 1.2 LED封装的常见要素

##### 1.2.1 LED引脚成形方法

##### 1.2.2 LED弯脚及切脚

##### 1.2.3 LED清洗

##### 1.2.4 LED过流保护

##### 1.2.5 LED焊接条件

### 第二章 2014-2016年LED封装产业综合发展分析

## 2.1 2014-2016年世界LED封装业发展状况

### 2.1.1 总体特征

### 2.1.2 区域分布

### 2.1.3 市场发展

### 2.1.4 企业格局

## 2.2 2014-2016年中国LED封装业发展总体情况

### 2.2.1 行业综述

### 2.2.2 产值规模

在成本优势明显、应用领域需求与封装厂商扩产的推动下，我国早已成为最大的“全球LED封装器件生产基地”，国产化率快速提升。

大陆封装产值占比连年提升，转移趋势明显

大陆LED封装产值增长

### 2.2.3 产品结构

### 2.2.4 价格分析

## 2.3 2014-2016年国内重要LED封装项目进展

### 2.3.1 欧司朗在华首个LED封装项目投产

### 2.3.2 福建安溪引进LED封装线项目

### 2.3.3 晶圆级芯片封装项目落户淮安

### 2.3.4 厦门信达增资扩建LED封装项目

### 2.3.5 木林森投资LED封装项目

### 2.3.6 鸿利光电投建LED基地

## 2.4 SMD LED封装

### 2.4.1 SMD LED封装市场发展简况

### 2.4.2 SMD LED封装技术壁垒较高

### 2.4.3 SMD LED封装产能尚未过剩

## 2.5 LED封装业发展中存在的问题

### 2.5.1 LED封装业发展的制约因素

### 2.5.2 LED封装企业面临的挑战

### 2.5.3 传统封装工艺成系统成本瓶颈

### 2.5.4 LED封装业市场盈利难度大

## 2.6 促进中国LED封装业发展的策略

- 2.6.1 LED封装产业增强对策
- 2.6.2 LED封装行业发展措施
- 2.6.3 LED封装业需加大研发投入
- 2.6.4 LED封装业应向高端转型

### 第三章 2014-2016年中国LED封装市场整体格局分析

- 3.1 2014-2016年LED封装市场发展态势
  - 3.1.1 市场运行特征
  - 3.1.2 市场需求量
  - 3.1.3 市场地位分析
  - 3.1.4 企业发展状况
  - 3.1.5 市场发展变化
  - 3.1.6 上下游间战略合作
- 3.2 2014-2016年LED封装企业布局特征
  - 3.2.1 区域分布格局
  - 3.2.2 珠三角地区
  - 3.2.3 长三角地区
  - 3.2.4 其他地区
- 3.3 2014-2016年广东省LED封装业运营状况
  - 3.3.1 产业规模
  - 3.3.2 主要特点
  - 3.3.3 重点市场
  - 3.3.4 发展趋势
- 3.4 2014-2016年LED封装市场竞争格局
  - 3.4.1 LED封装市场竞争加剧
  - 3.4.2 LED封装市场竞争主体
  - 3.4.3 台湾厂商扩大封装产能
  - 3.4.4 本土企业布局背光封装
  - 3.4.5 封装企业竞争焦点分析
- 3.5 2015-2016年LED封装企业竞争力简析
  - 3.5.1 2014年本土COB封装企业竞争力排名
  - 3.5.2 2014年LED封装硅胶企业竞争力排名

3.5.3 2014年LED照明白光封装企业竞争力排名

3.5.4 2015年LED照明白光封装企业竞争力排名

#### 第四章 2014-2016年LED封装行业技术研发进展

##### 4.1 中外LED封装技术的差异

4.1.1 封装生产及测试设备差异

4.1.2 LED芯片差异

4.1.3 封装辅助材料差异

4.1.4 封装设计差异

4.1.5 封装工艺差异

4.1.6 LED器件性能差异

##### 4.2 2014-2016年中国LED封装技术研发分析

4.2.1 LED封装技术重要性分析

4.2.2 LED封装专利申请状况

4.2.3 LED封装行业技术特点

4.2.4 LED封装技术创新进展

4.2.5 LED封装技术壁垒分析

4.2.6 LED封装业技术研发仍需加强

##### 4.3 LED封装关键技术介绍

4.3.1 功率型LED封装的关键技术

4.3.2 显示屏用LED封装的技术要求

4.3.3 固态照明对LED封装的技术要求

#### 第五章 2014-2016年LED封装设备及封装材料的发展

##### 5.1 2014-2016年LED封装设备市场分析

5.1.1 LED封装设备需求特点

5.1.2 LED封装设备市场格局

5.1.3 LED封装设备国产化现状

5.1.4 LED前端封装设备竞争加剧

5.1.5 LED后端封装设备市场态势

5.1.6 LED封装设备市场发展方向

5.1.7 LED封装设备市场规模预测

## 5.2 LED封装的主要材料介绍

### 5.2.1 LED芯片

### 5.2.2 荧光粉

### 5.2.3 散热基板

### 5.2.4 热界面材料

### 5.2.5 有机硅材料

## 5.3 2014-2016年中国LED封装材料市场分析

### 5.3.1 LED封装材料市场现状

### 5.3.2 LED芯片市场发展规模分析

### 5.3.3 LED封装辅料市场价格走势

### 5.3.4 LED封装辅料市场专利风险

### 5.3.5 LED荧光粉市场创新技术分析

### 5.3.6 LED荧光粉市场发展展望

### 5.3.7 LED封装环氧树脂市场潜力

### 5.3.8 LED封装用基板材料市场走向

## 5.4 2014-2016年LED封装支架市场分析

### 5.4.1 LED封装支架市场发展规模

### 5.4.2 LED封装支架市场竞争格局

### 5.4.3 LED封装支架市场技术路线

### 5.4.4 LED封装PCT支架市场前景

### 5.4.5 LED封装支架技术发展趋势

## 第六章 2014-2016年国外及台湾重点LED封装企业运营状况分析

### 6.1 国外主要LED封装重点企业

#### 6.1.1 日亚化学 (NICHIA)

#### 6.1.2 欧司朗(OSRAM GmbH)

#### 6.1.3 三星电子 (SAMSUNG ELECTRONICS)

#### 6.1.4 首尔半导体 (SSC)

#### 6.1.5 科锐 (CREE)

### 6.2 台湾主要LED封装重点企业

#### 6.2.1 亿光电子

#### 6.2.2 隆达电子

- 6.2.3 光宝集团
- 6.2.4 东贝光电
- 6.2.5 宏齐科技
- 6.2.6 佰鸿股份

## 第七章 2014-2016年中国内地LED封装上市公司运营状况分析

### 7.1 木林森股份有限公司

- 7.1.1 企业发展概况
- 7.1.2 经营效益分析
- 7.1.3 业务经营分析
- 7.1.4 财务状况分析
- 7.1.5 未来前景展望

### 7.2 国星光电股份有限公司

- 7.2.1 企业发展概况
- 7.2.2 经营效益分析
- 7.2.3 业务经营分析
- 7.2.4 财务状况分析
- 7.2.5 未来前景展望

### 7.3 深圳雷曼光电科技股份有限公司

- 7.3.1 企业发展概况
- 7.3.2 经营效益分析
- 7.3.3 业务经营分析
- 7.3.4 财务状况分析

### 7.4 深圳市瑞丰光电子股份有限公司

- 7.4.1 企业发展概况
- 7.4.2 经营效益分析
- 7.4.3 业务经营分析
- 7.4.4 财务状况分析
- 7.4.5 未来前景展望

### 7.5 深圳市聚飞光电股份有限公司

- 7.5.1 企业发展概况
- 7.5.2 经营效益分析



- 7.5.3 业务经营分析
- 7.5.4 财务状况分析
- 7.5.5 未来前景展望
- 7.6 广州市鸿利光电股份有限公司
  - 7.6.1 企业发展概况
  - 7.6.2 经营效益分析
  - 7.6.3 业务经营分析
  - 7.6.4 财务状况分析
  - 7.6.5 未来前景展望
- 7.7 歌尔声学股份有限公司
  - 7.7.1 企业发展概况
  - 7.7.2 经营效益分析
  - 7.7.3 业务经营分析
  - 7.7.4 财务状况分析
  - 7.7.5 未来前景展望

## 第八章 中国LED封装产业发展趋势及前景预测（ZY CW）

- 8.1 LED封装产业未来发展趋势
  - 8.1.1 功率型白光LED封装技术趋势
  - 8.1.2 无金线封装成LED封装新走向
  - 8.1.3 LED封装产业未来发展方向
- 8.2 中国LED封装市场前景展望
  - 8.2.1 我国LED封装市场发展前景乐观
  - 8.2.2 LED封装产品应用市场将持续扩张
  - 8.2.3 中国LED封装行业产值规模预测
  - 8.2.4 中国LED封装行业需求量预测

### 图表目录：

- 图表1 LED产品封装结构的类型
- 图表2 2014-2016年全球LED厂商LED封装器件营收排名
- 图表3 第三类企业的发展运作模式
- 图表4 国际大部分著名LED企业遵循的发展模式

- 图表5 2010-2016年中国LED封装产值变化情况
- 图表6 不同LED封装类型产品图示
- 图表7 2016年我国LED封装器件不同功率产品占比
- 图表8 2015年国内LED封装市场重点企业整合动态
- 图表9 2010-2020年中国LED封装行业企业数量
- 图表10 广东部分LED封装企业的优势与特色
- 图表11 部分广东省企业和研究机构的封装技术发明专利分布
- 图表12 广东LED器件封装应用领域
- 图表13 2014年台湾重点LED封装厂商营业收入及其增长情况
- 图表14 2015年我国COB封装企业竞争力排行榜
- 图表15 2016年中国LED照明白光封装竞争力10强
- 图表16 2016年中国LED封装设备10强企业
- 图表17 2010-2020年中国LED分光编带机出货量及预测
- 图表18 2010-2020年中国LED分光编带机市场规模及预测
- 图表19 2015年全球MOCVD安装量
- 图表20 2014-2016年木林森股份有限公司总资产和净资产
- 图表21 2015-2016年木林森股份有限公司营业收入和净利润
- 图表22 2016年木林森股份有限公司营业收入和净利润
- 图表23 2015-2016年木林森股份有限公司现金流量
- 图表24 2016年木林森股份有限公司现金流量
- 图表25 2015年木林森股份有限公司主营业务收入分行业、产品、地区
- 图表26 2015-2016年木林森股份有限公司成长能力
- 图表27 2016年木林森股份有限公司成长能力
- 图表28 2015-2016年木林森股份有限公司短期偿债能力
- 图表29 2016年木林森股份有限公司短期偿债能力
- 图表30 2015-2016年木林森股份有限公司长期偿债能力
- 更多图表见正文&hellip;&hellip;

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/xiaojiadian/E17161YAWS.html>